MATERIAL
SCIENCE
SERVICE

汎銓科技 半導體產業高階製程領航者
www.msscorps.com

汎銓科技股份有限公司

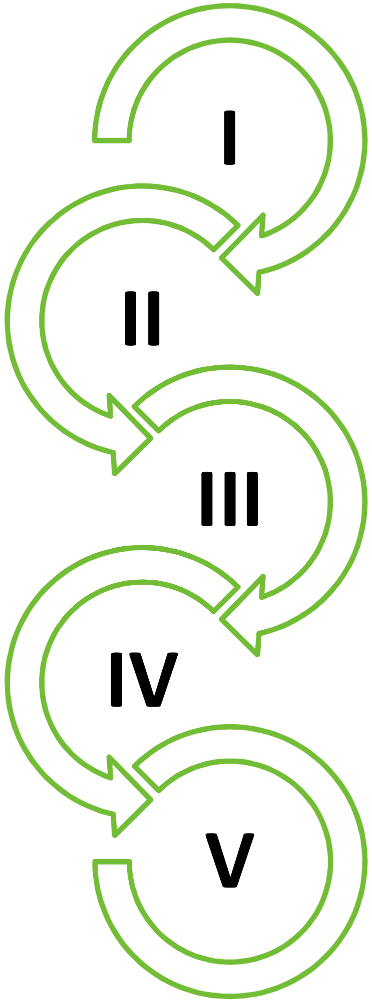
2022年Q4 (自結)Financial Review

Form No: Q4-MA01 Ver.1.2

免責聲明 Disclaimer

- This presentation includes forward-looking statements. All statements, other than statements of historical facts, that address activities, events or developments that Material Science Service Corp. expects or anticipates will or may occur in the future (including but not limited to projections, targets, estimates and business plans) are forward-looking statements.
- MSS's actual results or developments may differ materially from those indicated by these forward-looking statements as a result of various factors and uncertainties, including but not limited to market demand, change in legal, financial and regulatory frameworks, government policies, financial market conditions, and other risks and factors beyond our control.
- MSS does not undertake any obligation to publicly update any forward-looking statement to reflect events or circumstances after the date on which any such statement is made or to reflect the occurrence of unanticipated events.

公司基本資料



汎銓科技股份有限公司
MSSCORPS CO.,LTD.(英文簡稱:MSS)

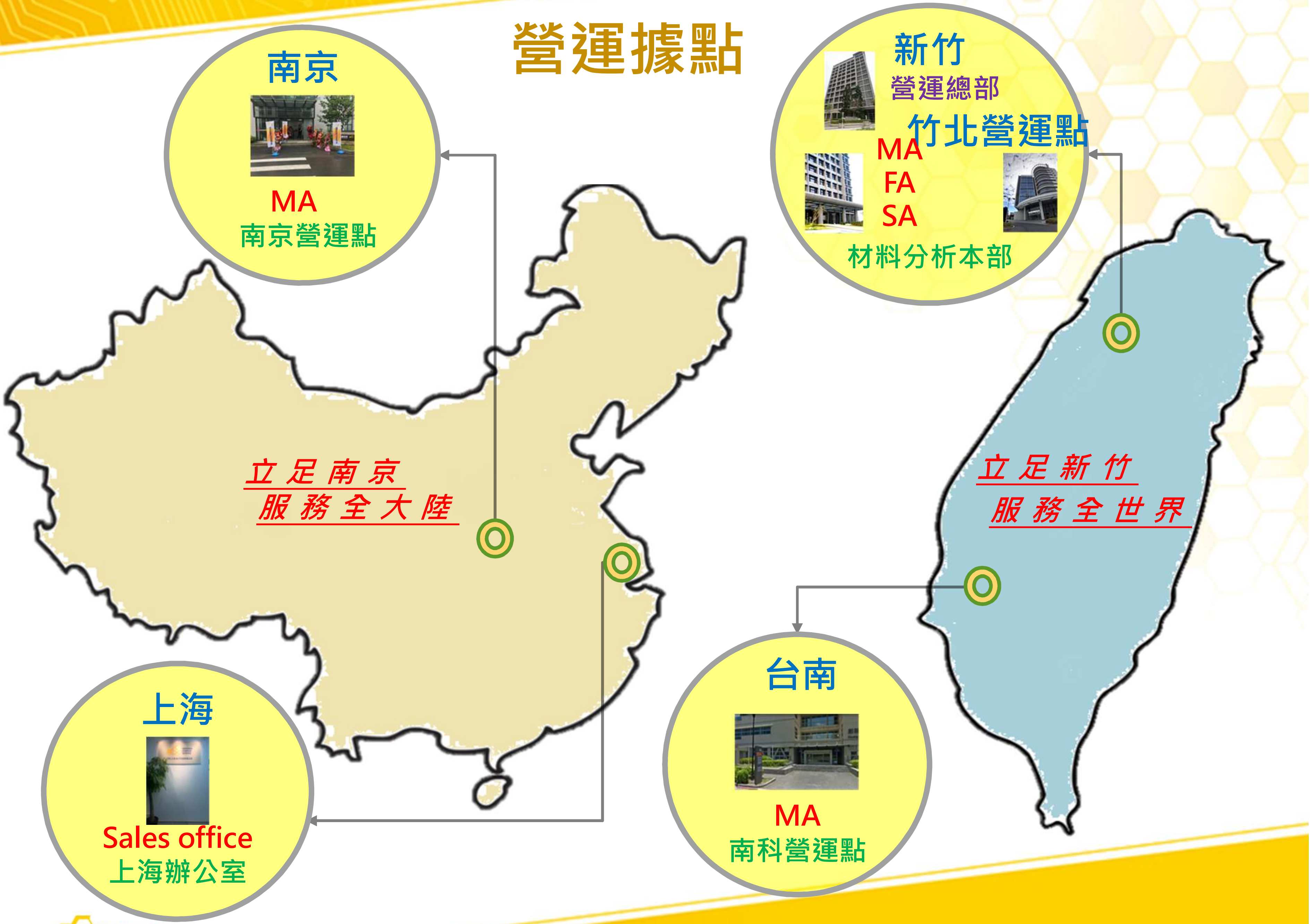
設立時間: 民國94年7月27日
上市掛牌: 民國111年8月31日

創辦人: 柳紀綸董事長兼總經理

資本額: 新台幣4.68億元/員工: 約500人

服務項目: 材料分析服務(MA)、故障分析服務(FA)

營運據點



南京

MA
南京營運點

新竹
營運總部
竹北營運點

MA
FA
SA
材料分析本部

立 足 南 京
服 務 全 大 陸

立 足 新 竹
服 務 全 世 界

上海

Sales office
上海辦公室

台南

MA
南科營運點

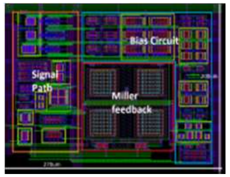
汎銓在半導體產業鏈扮演的角色-FA

項目&定位 | **內　　　容**

故障分析服務

(IC產品醫院)

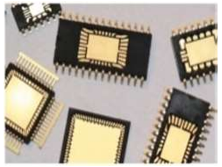
IC設計/光罩



IC設計除錯與找出IC故障真因，讓客戶產品快速Time to market

1.IC電路修補，讓designer找出設計錯誤點，並**確認更改設計的有效性**
2.IC量產後，針對不良品，進行電測/故障點標定/結構/成份分析
運用 EFA & PFA 技術**找出IC故障真因**

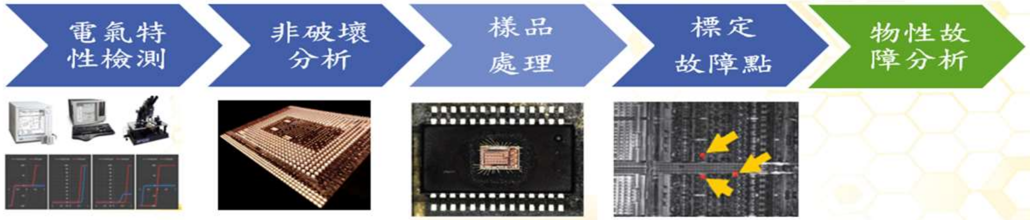
封測/載板/軟板/PCB 等



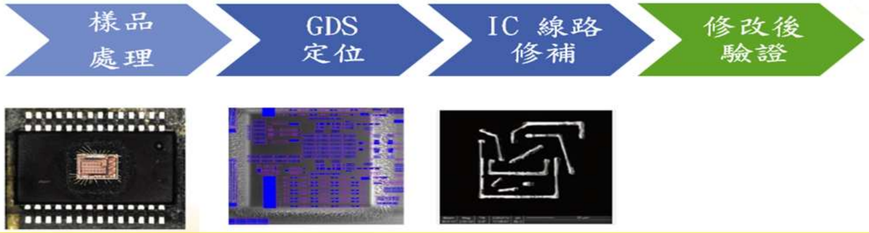
汎銓的**低損傷分析技術**，從晶圓代工取得絕對優勢，擴展到半導體下游

1.材料多樣性/硬度差異/越做越薄/層和層結合力越來越弱
2.開發一系列保護試片專利，減少熱和電的影響，避免產生**人為缺陷**

故障分析流程



電氣特性檢測 → 非破壞分析 → 樣品處理 → 標定故障點 → 物性故障分析



樣品處理 → GDS定位 → IC 線路修補 → 修改後驗證

汎銓在半導體產業鏈扮演的角色-MA

項目&定位 | **內　　容**

材料分析服務

(研發領航者)

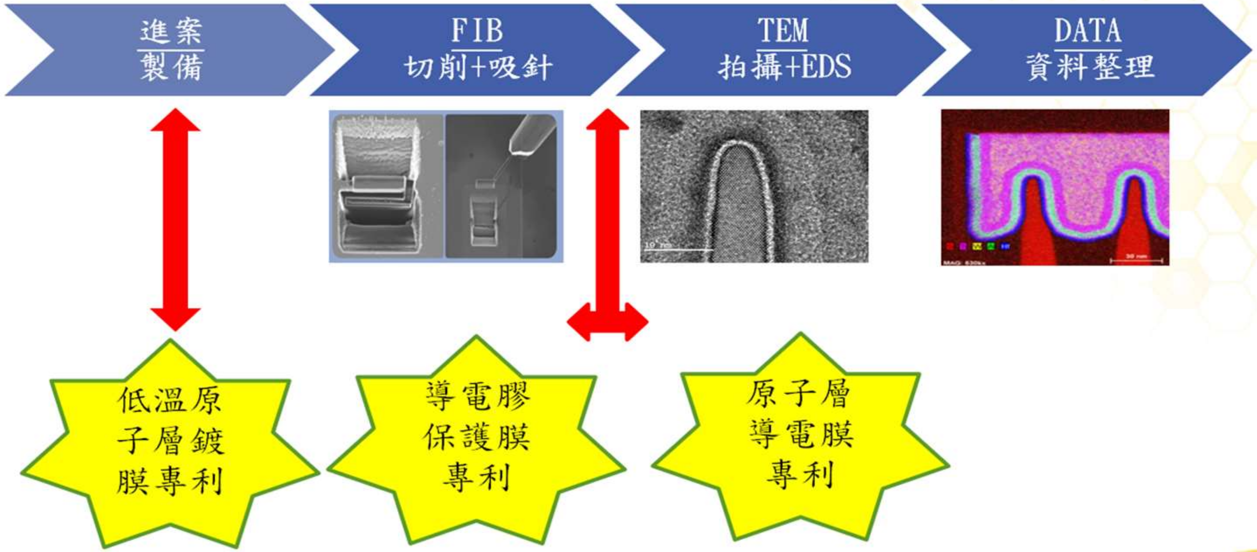
晶圓代工/設備/材料

提供電晶體結構與成份分析，讓FAB 快速達成以下任務

汎銓技術停滯或速度變慢，我們的客戶研發時程就會延誤！

1.研發最先進製程，決定 **新設備的機型/新材料/製程參數**
2.導入量產，新建產線的機台，必須證明與RD line 一致性
3.量產中，產線持續良率提昇

材料分析流程



進案製備

FIB 切削+吸針

TEM 拍攝+EDS

DATA 資料整理

低溫原子層鍍膜專利

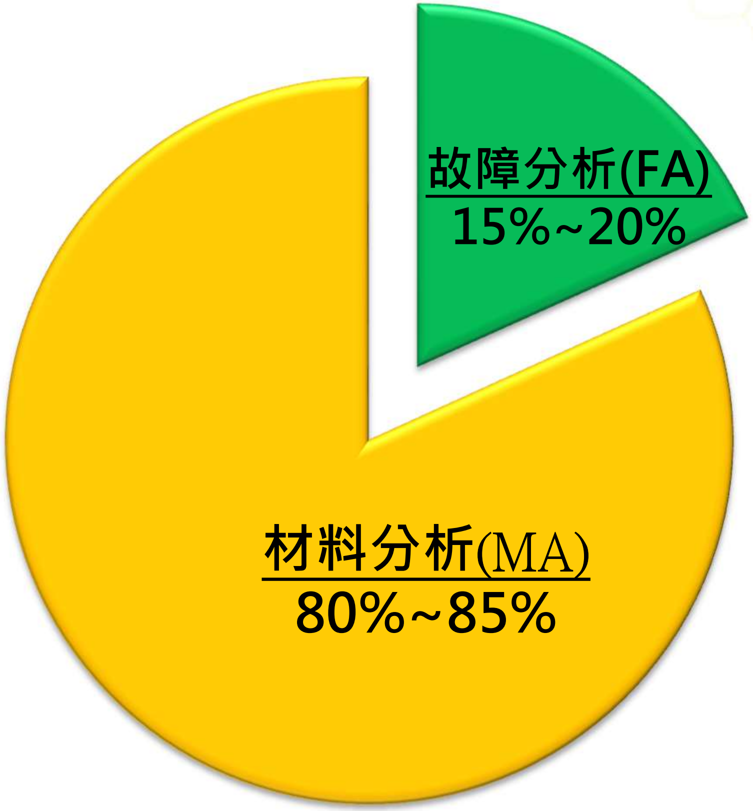
導電膠保護膜專利

原子層導電膜專利

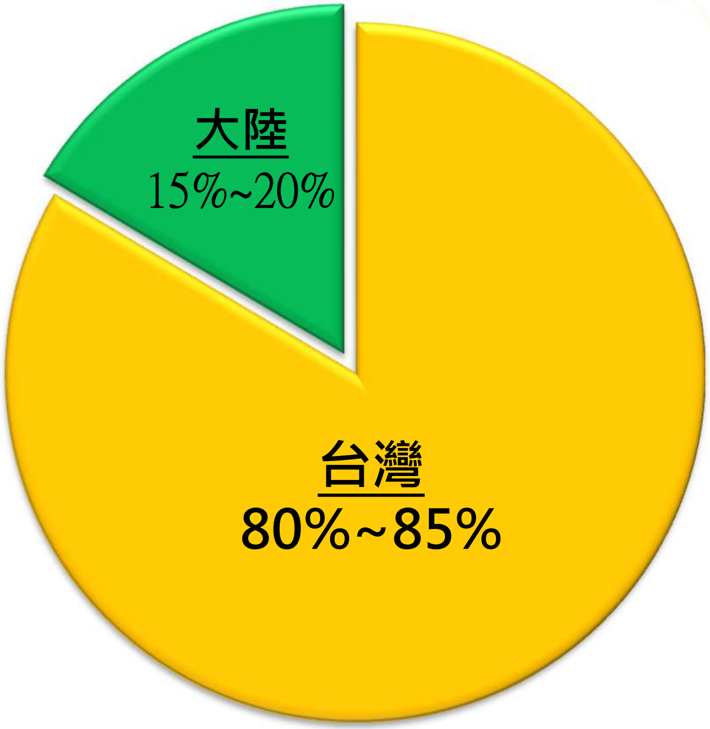
合併綜合損益表(自結)

(新台幣/千元)	111/10/01-12/31(自結)	110/10/01-12/31	YoY	111/01/01-12/31(自結)	110/01/01-12/31	YoY
營業收入	472,289	425,539	11%	1,726,274	1,469,881	17%
營業毛利	**210,685**	**176,567**	**19%**	**694,773**	**555,106**	**25%**
毛利率 %	**45**	**41**	**10%**	**40**	**38**	**5%**
營業費用	(93,135)	(63,129)	48%	(317,601)	(259,329)	14%
營業淨利	117,550	113,438	4%	377,172	295,777	22%
營業外收支	(2,606)	(776)	236%	(2,674)	(1,035)	158%
稅前淨利	114,944	112,662	2%	371,891	294,742	26%
稅前EPS(元)	2.66	-	-	8.62	-	-

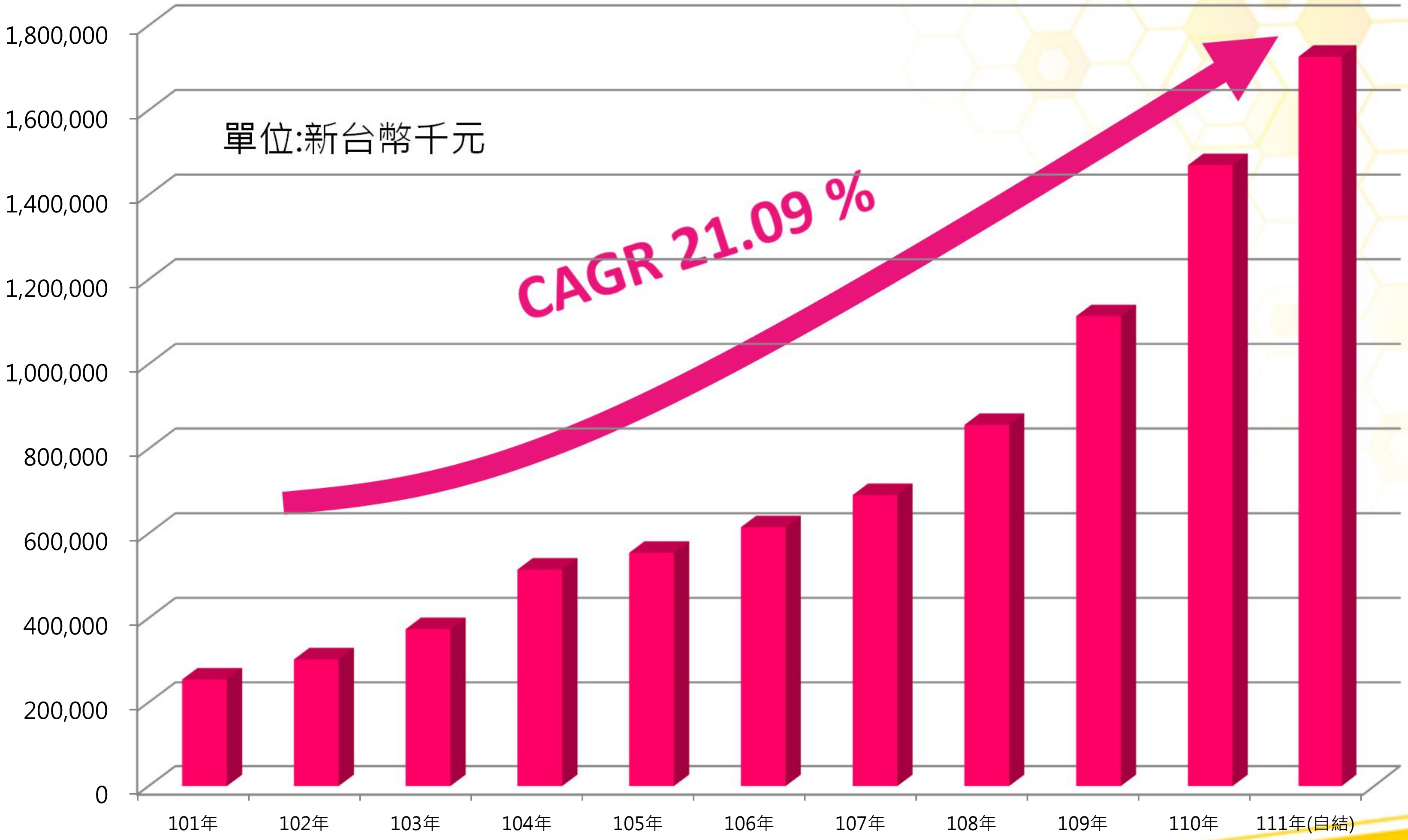
產品組合-2022年Q4



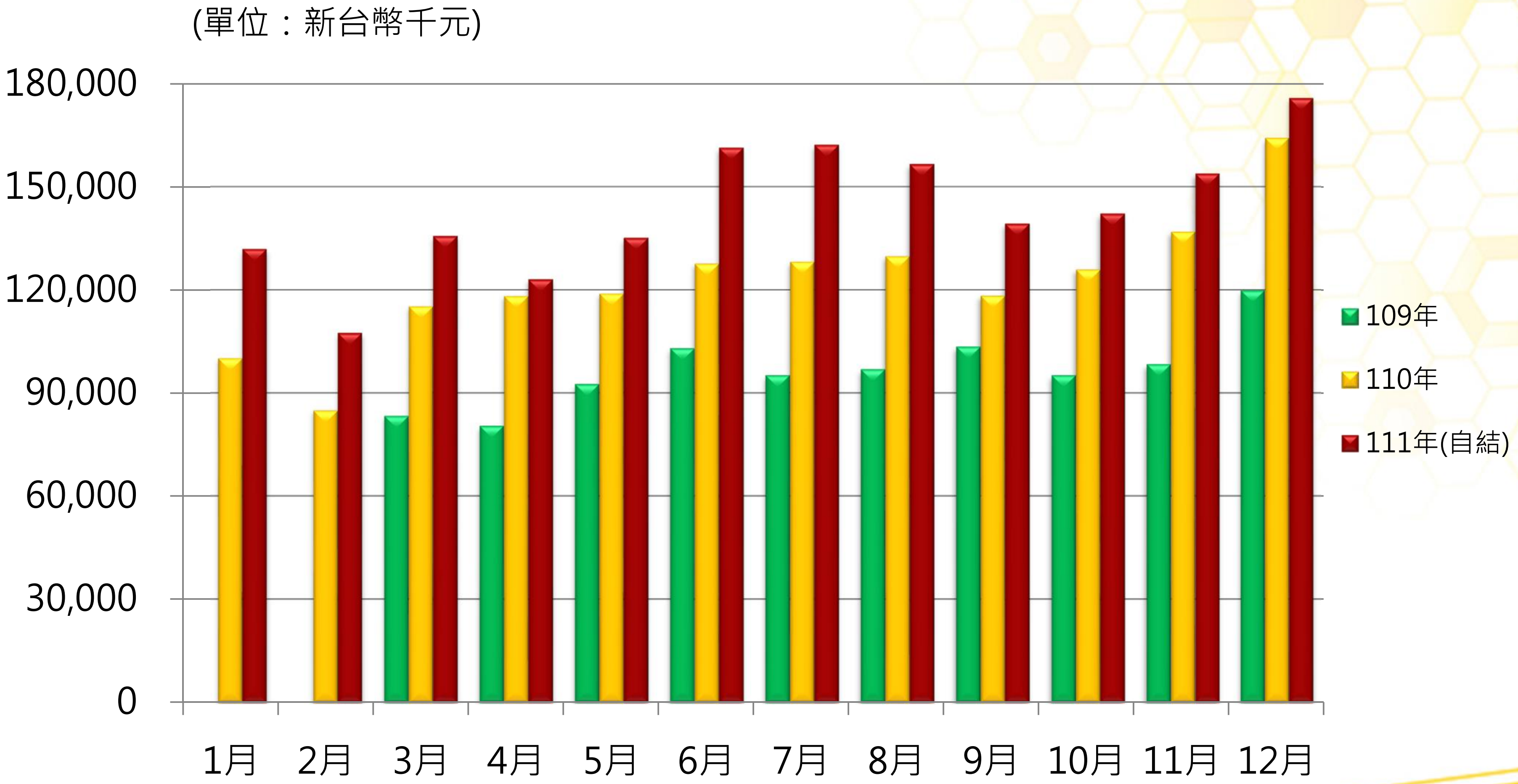
區域別營收比重-2022年Q4



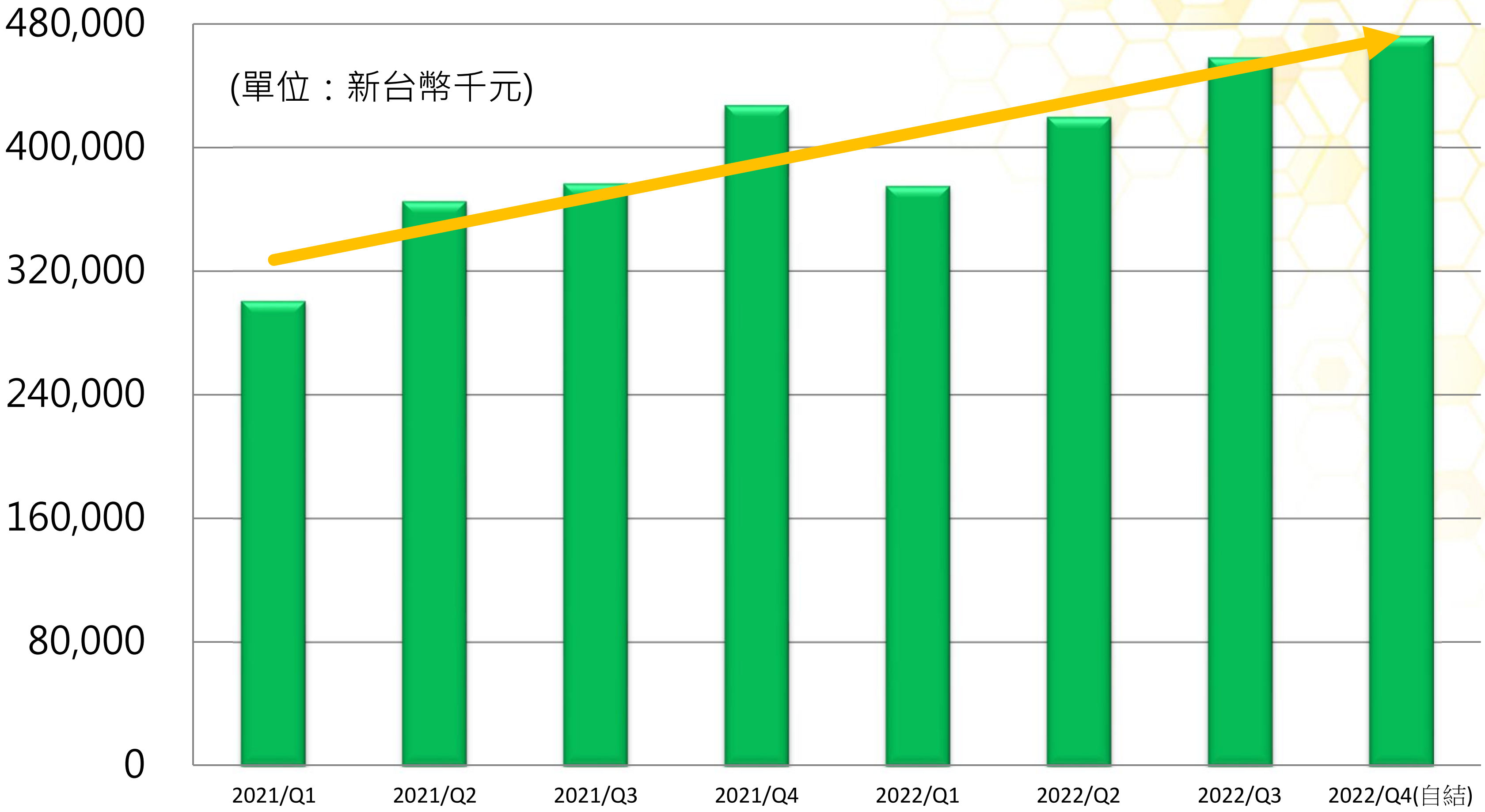
最近十年度營收成長趨勢



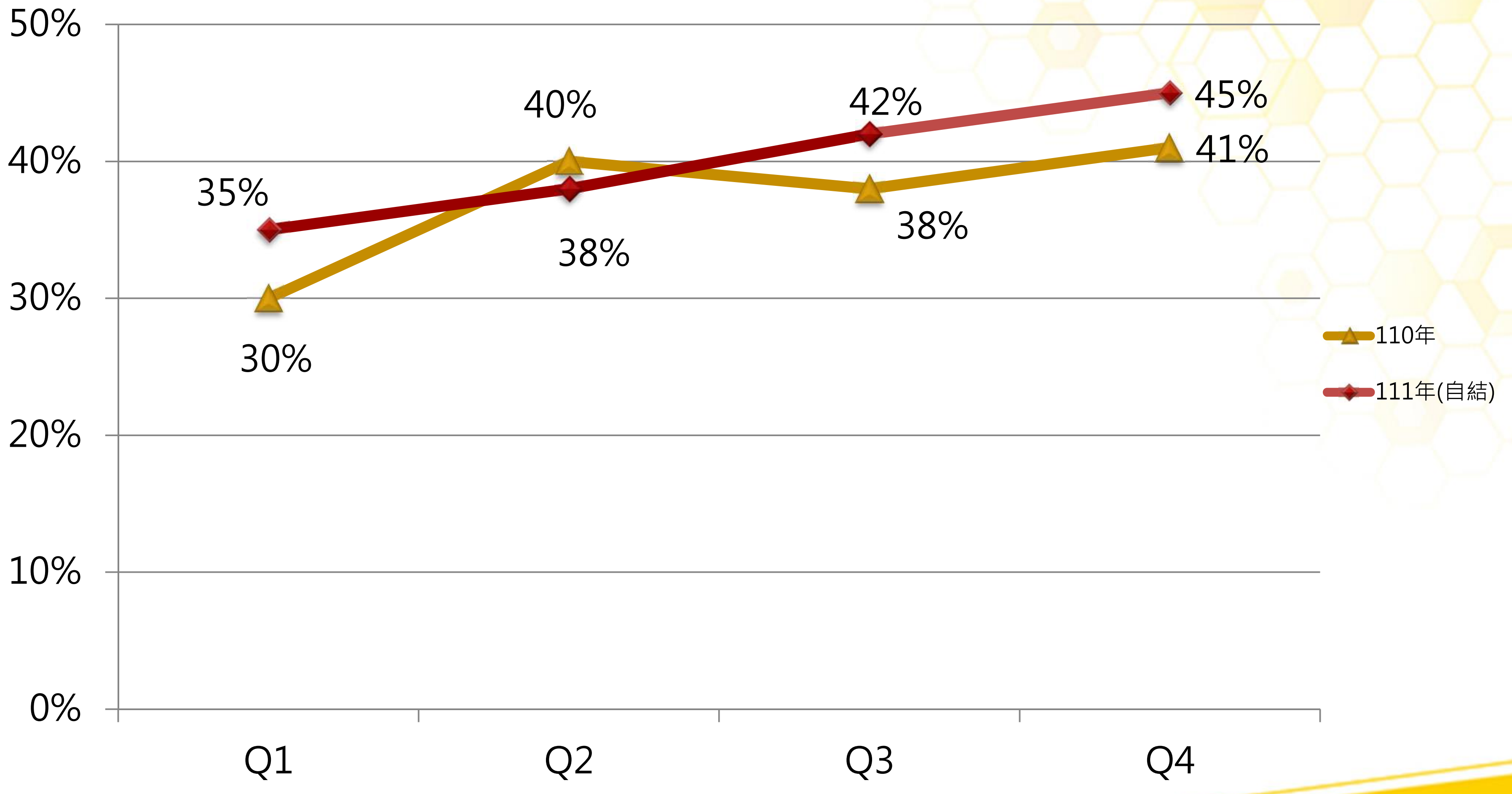
2020-2022 營收月趨勢



2021-2022 營收季趨勢

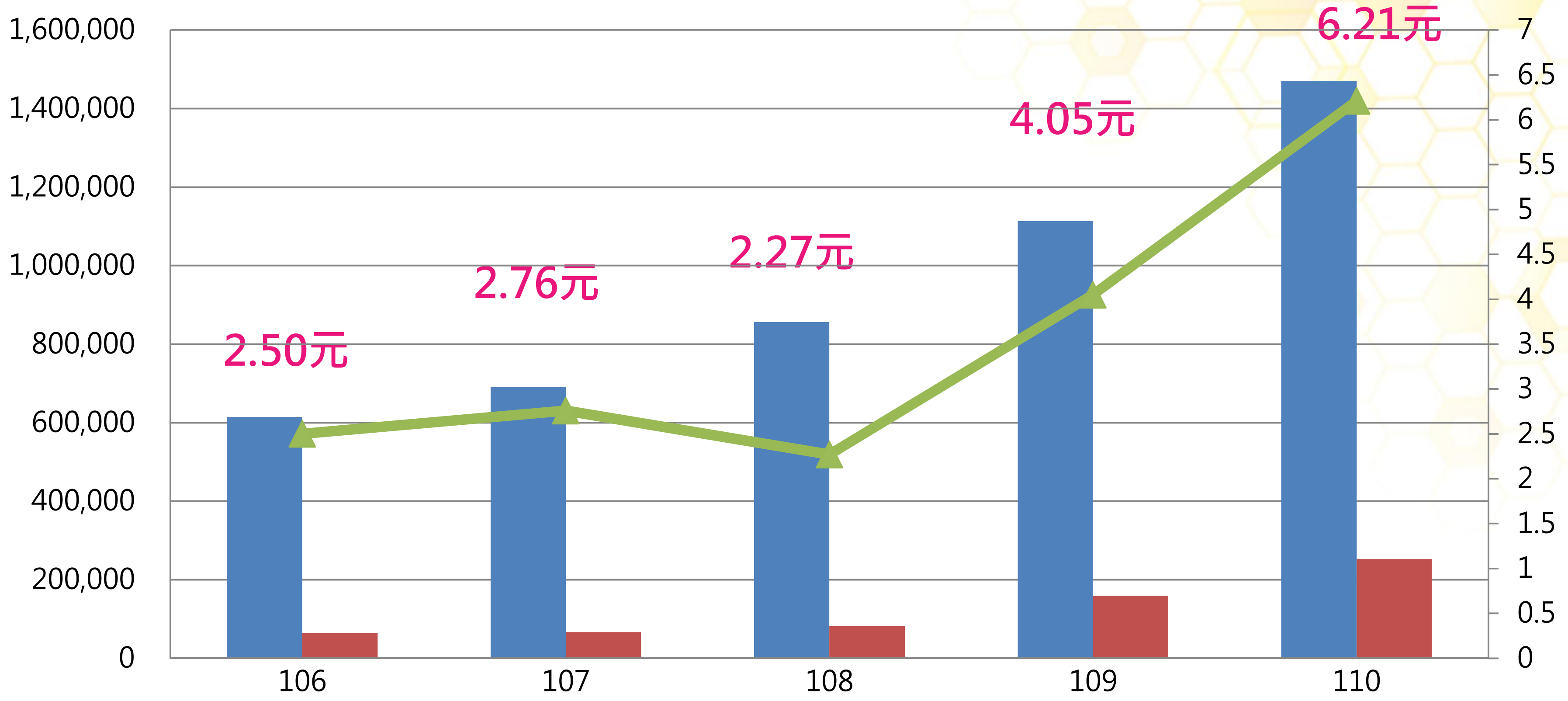


毛利率分析(自結)



最近五年度獲利表現與股利分配

單位:新台幣千元/元



	106	107	108	109	110
🟦 營業收入	614,603	690,630	856,306	1,113,184	1,469,881
🟥 稅後純益	64,072	66,538	81,764	159,106	252,493
▲ EPS	2.5	2.76	2.27	4.05	6.21
股利分配	**1.16**	**2**	**2**	**2.5**	**4.5**

感謝聆聽，敬請指導

MATERIAL
SCIENCE
SERVICE

Your best R&D partner

1F,NO.27,Pu-ding Rd., Hsin-chu
30072,Taiwan,R.O.C

☎ **+886-3-6663298**

✉ **service@msscorps.com**